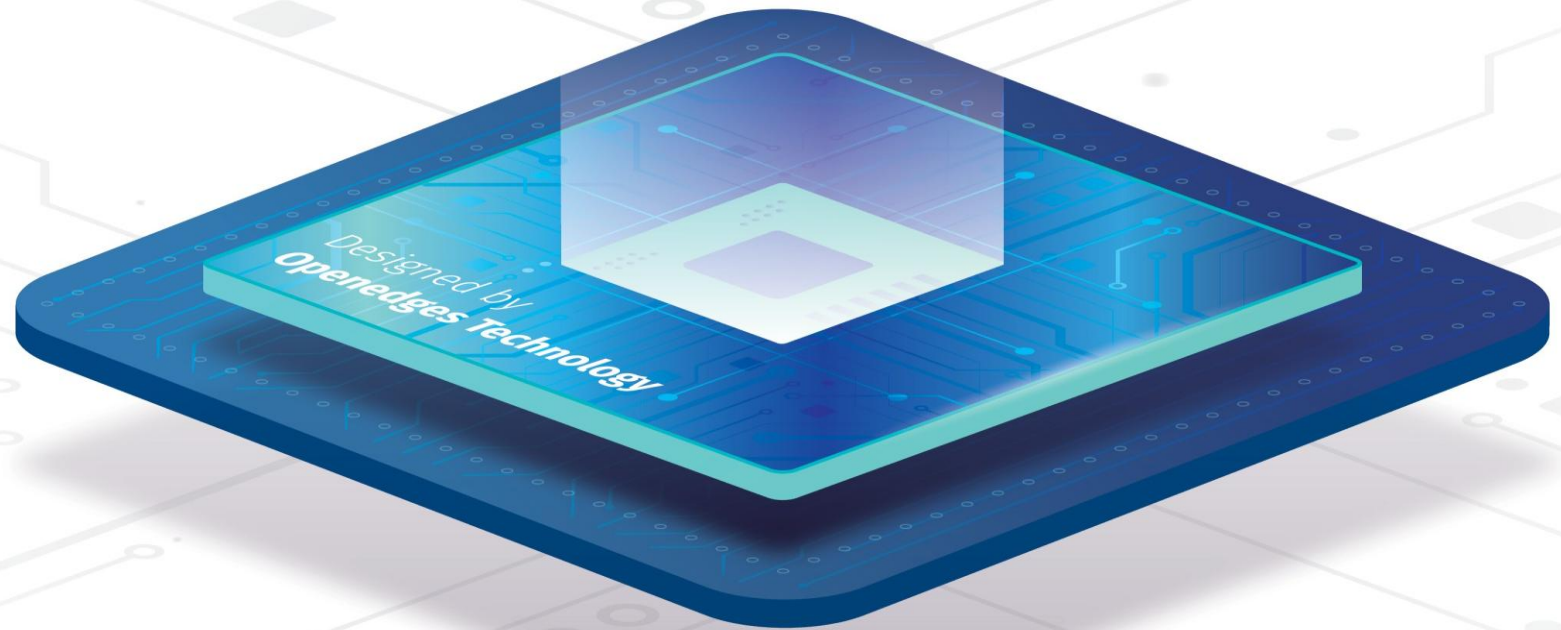


AI for Everyone, Everywhere



Disclaimer

본 자료는 기관투자자와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서 정보 제공을 목적으로 오픈엣지테크놀로지 주식회사 (이하 "회사")에 의해 작성됐으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 presentation의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 받아들이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당될 수 있습니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 미래 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)'등과 같은 단어를 포함합니다. 위 "예측정보"는 경영 환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

미래 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 시장 환경과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대해 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 하지 않으며, 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

The Future of AI Computing

Table of Contents

Openedges
Technology
At a Glance

Prologue

01
시스템 반도체 시장의
구조적 성장

02
국가대표 AI 반도체 IP 설계 기업,
오픈엣지테크놀로지

03
'24년 3Q 경영실적

04
중장기 성장전략

Appendix

Openedges Technology at a Glance

99%

연매출 성장률(최근 5년)

* '19년~'23년



60

누적 라이선스 계약

* '24년 9월말 기준



153

Global R&D Engineers

* 전체 인력(177명)중 86%
(한국 최대규모)



AI for Everyone, Everywhere

OPENEDGES

30+

고객사 수

* 삼성전자, SK Hynix, Micron 등
글로벌 Top-tier 고객 기 확보



20+

판매가능 IP 제품 수

* IP 종류는 총 4종이며
각 제품군 내 판매가능 개별 IP 제품 수



4

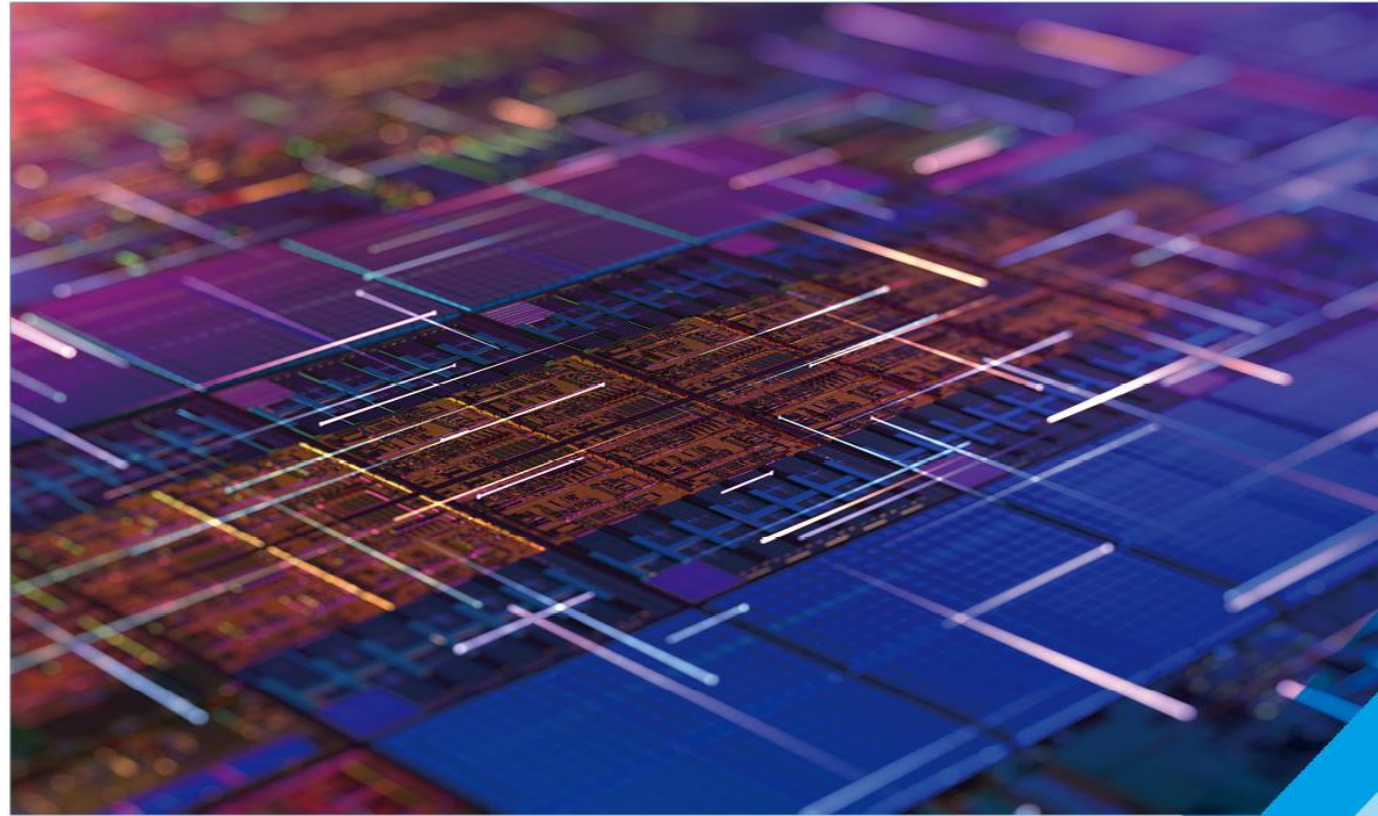
글로벌 R&D 센터

* 한국, 미국, 캐나다, 일본 소재



Prologue

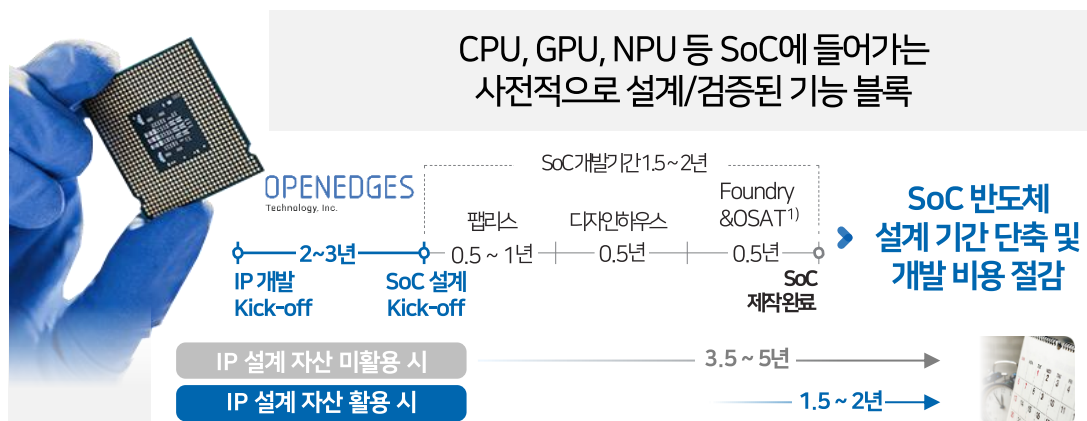
오픈엣지테크놀로지 사업 영역



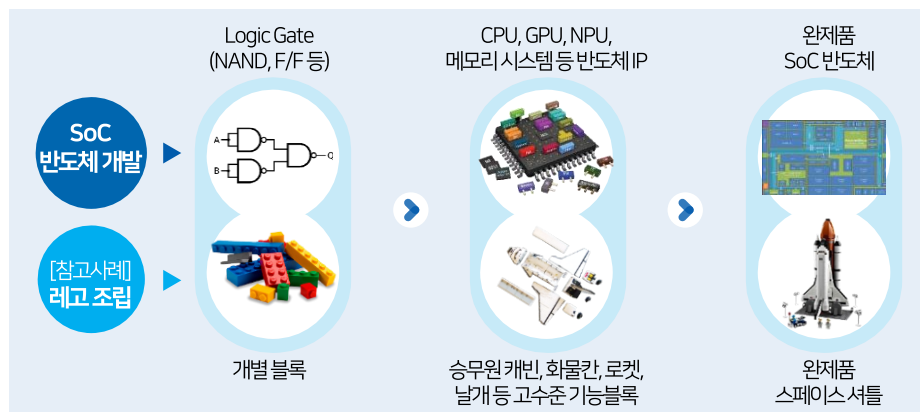
오픈엣지테크놀로지 사업 영역 ①

반도체 IP는 AI 반도체를 포함한 SoC (System on Chip)의 개발 기간 단축과 비용 절감 및 천억 원 이상 규모의 개발 실패의 위험을 경감시키는 높은 수준의 기술력이 요구되는 Ready-made 솔루션

반도체 IP란?



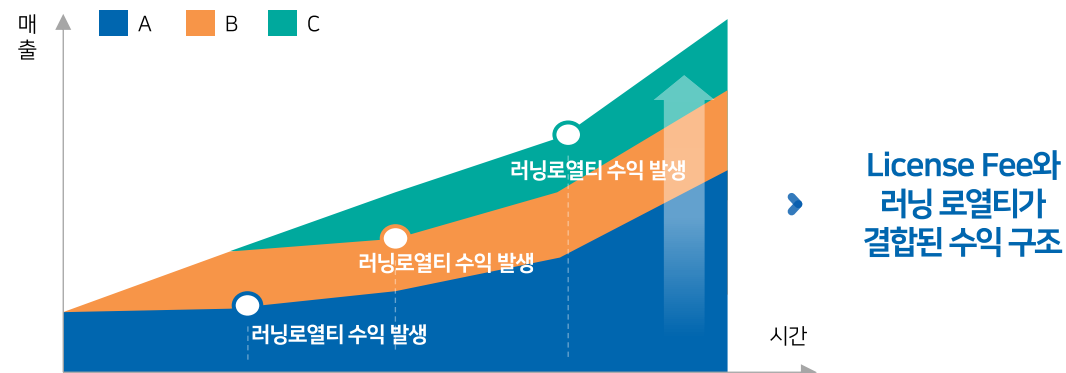
참고 사례



반도체 IP 사업의 수익 구조



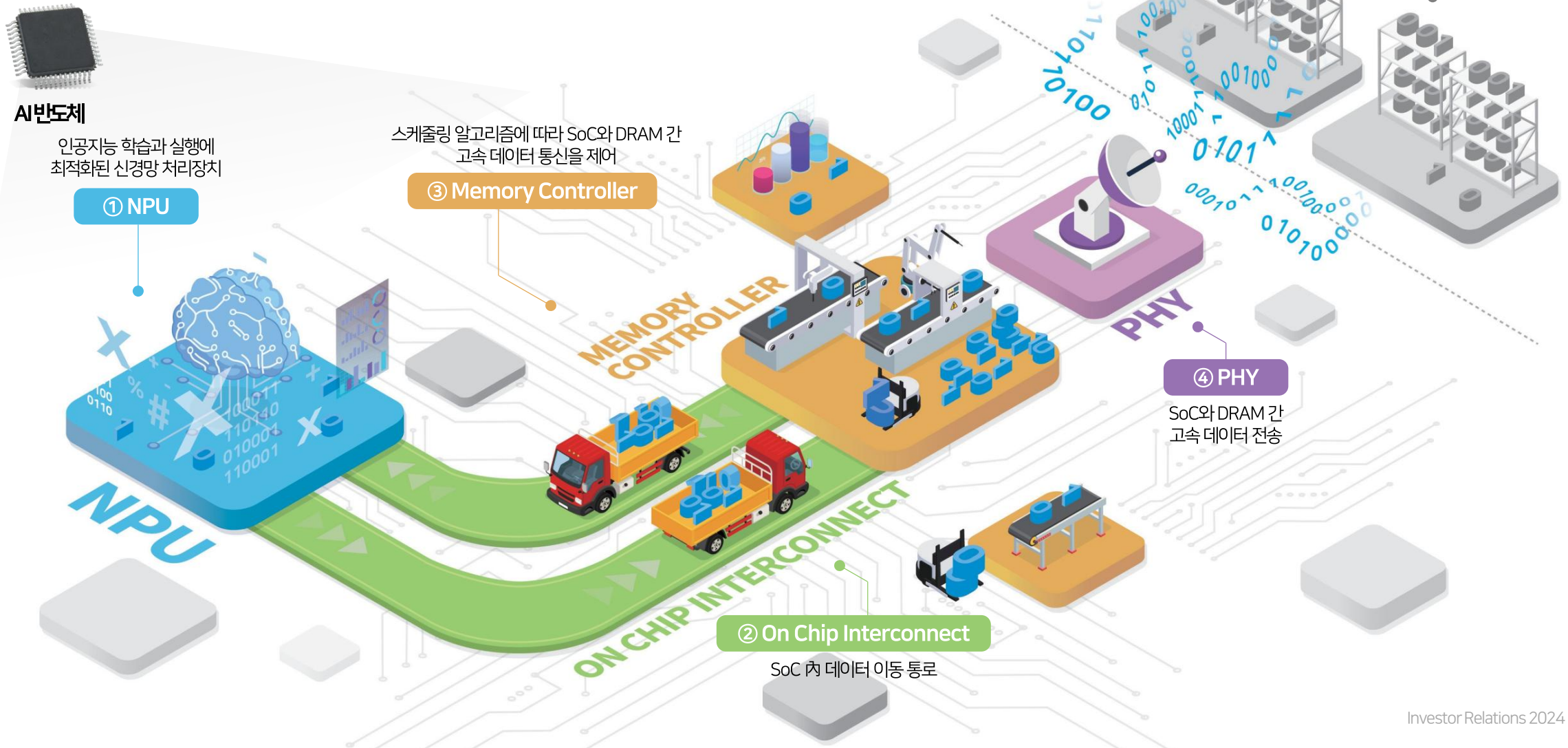
※ 반도체 IP 업계는 높은 기술장벽으로 소수 플레이어의 과점시장



* 주1) Outsourced Semiconductor Assembly and Test (패키징 등 후공정 업체)

오픈엣지테크놀로지 사업 영역 ②

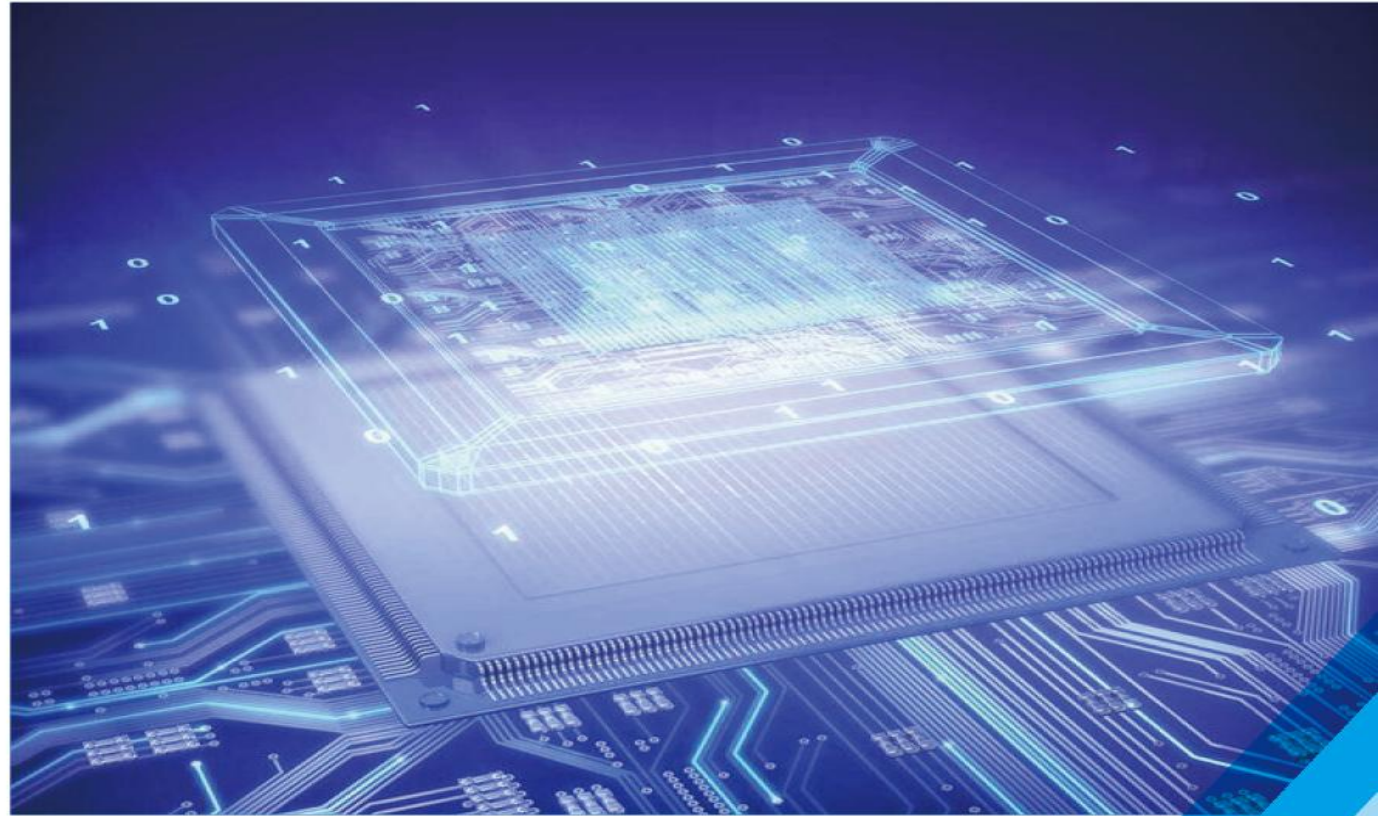
AI 반도체의 구동 기반이 되는 통합 IP 솔루션 설계 및 제공



01

시스템 반도체 시장의 구조적 성장

- 01. AI반도체 및 IP 시장 성장
- 02. 반도체 IP 설계업체의 역할



01 | AI 반도체 및 IP 시장 성장

AI 반도체와 IP 시장의 견조한 성장세 지속

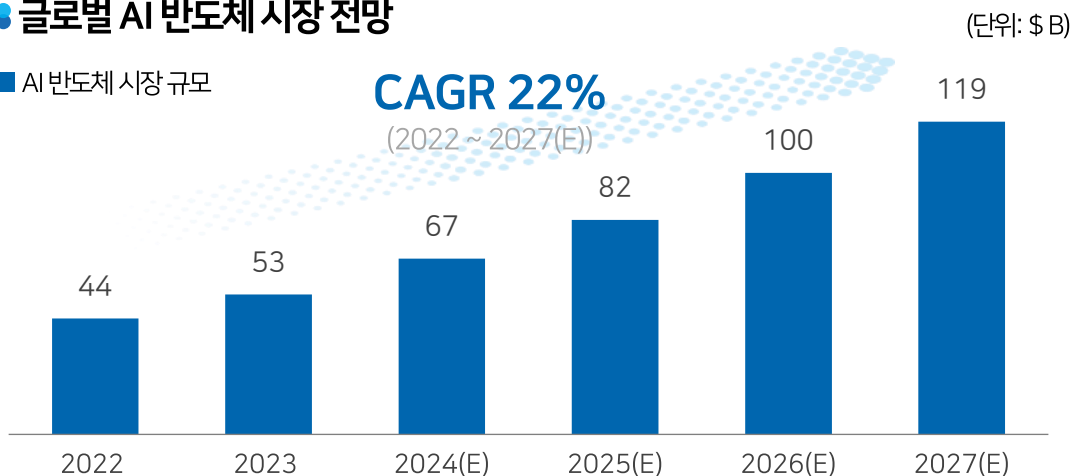
2024년 글로벌 반도체 시장 전망



※ Source: Semiconductor Market Forecast (WSTS, Jun 2024), 공개별소자/센서제외 기준

글로벌 AI 반도체 시장 전망

AI 반도체 시장 규모

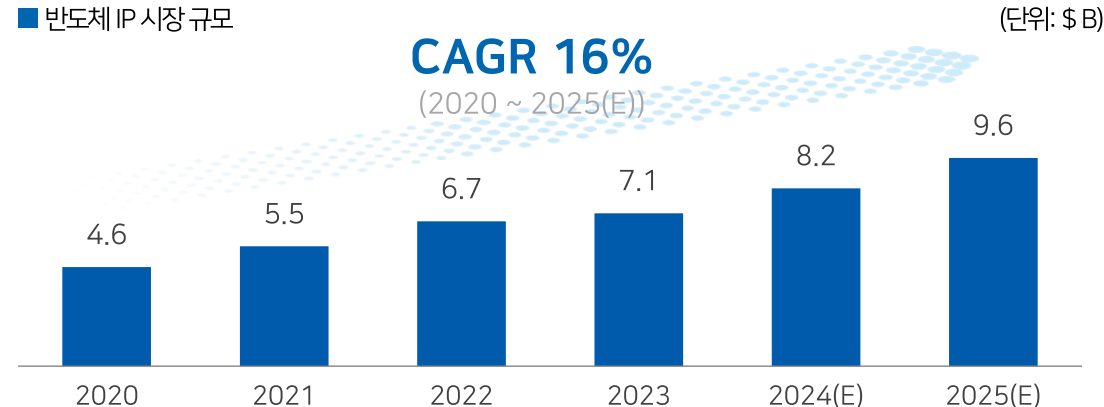


※ Source: AI Semiconductor (Gartner, Aug 2023), 당사 추정

반도체 IP 시장 전망 및 경쟁 현황

업체명	2023 매출 (\$ M)	CAGR ('19 ~ '23)
arm	2,938	10%
synopsys®	1,542	17%
cadence®	396	11%
...	...	...
OPENEDGES	15	99%
...	...	...
Others	...	14%
Total		16%

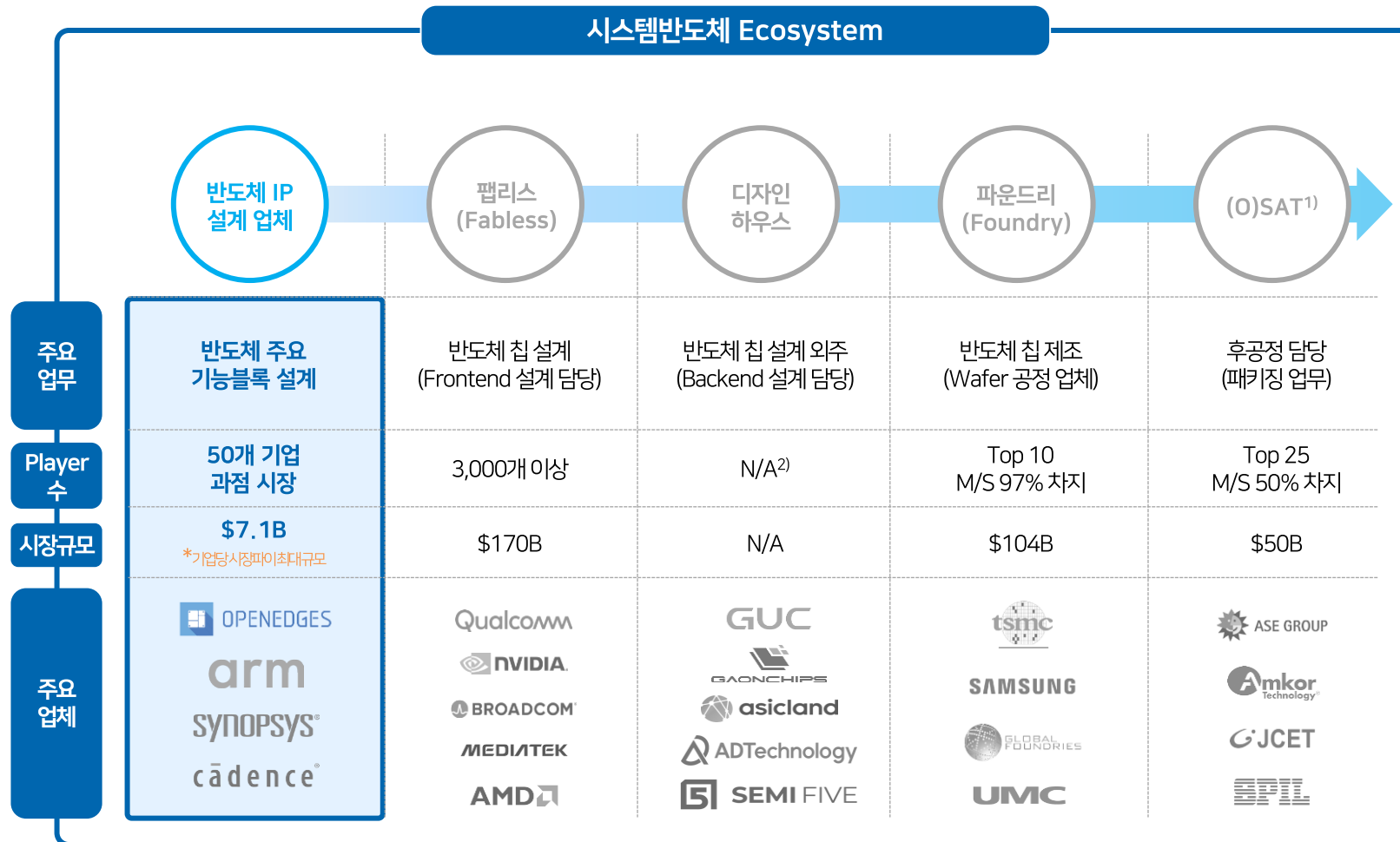
반도체 IP 시장 규모



※ Source: Design IP revenues (Ipnest, Apr 2024), Press Clipping

02 | 반도체 IP 설계 업체 역할

반도체 IP 기업은 팹리스 및 디자인하우스가 필요로 하는 기능 블록을 선제적 개발 및 공급



* 주1) (Outsourced) Semiconductor Assembly and Test: 반도체 패키지 조립 및 테스트 업체로 웨이퍼 공정 이후 후공정 담당

주2) Design House 시장은 공신력 있는 시장 규모 데이터 부재

IP시장의 과점화 이유

검증된 IP에 대한 니즈 증가



진입장벽이 높아
검증된 IP 업체의
희소 가치 부각



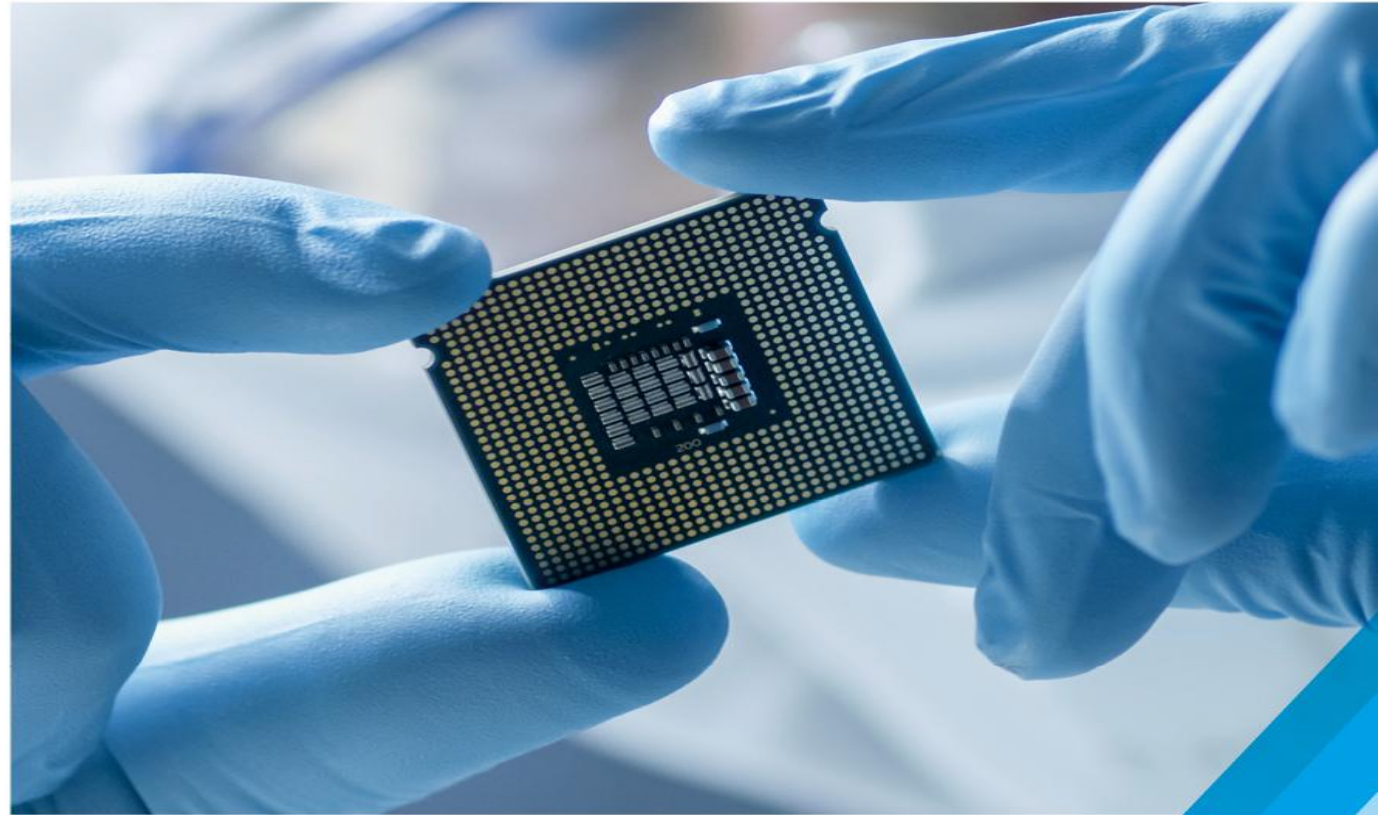
고도의
기술 인력
필요

최소 3년
이상의 R&D
투자 필요

02

국가대표 AI 반도체 IP 설계 기업, 오픈엠티테크놀로지

- 01. 오픈엠티테크놀로지 핵심경쟁력 Summary
- 02. 글로벌 최고 수준의 Manpower
- 03. 업계 최고 수준의 기술경쟁력
- 04. 검증된 글로벌 Track Record
- 05. 글로벌 기업과의 전략적 Partnership



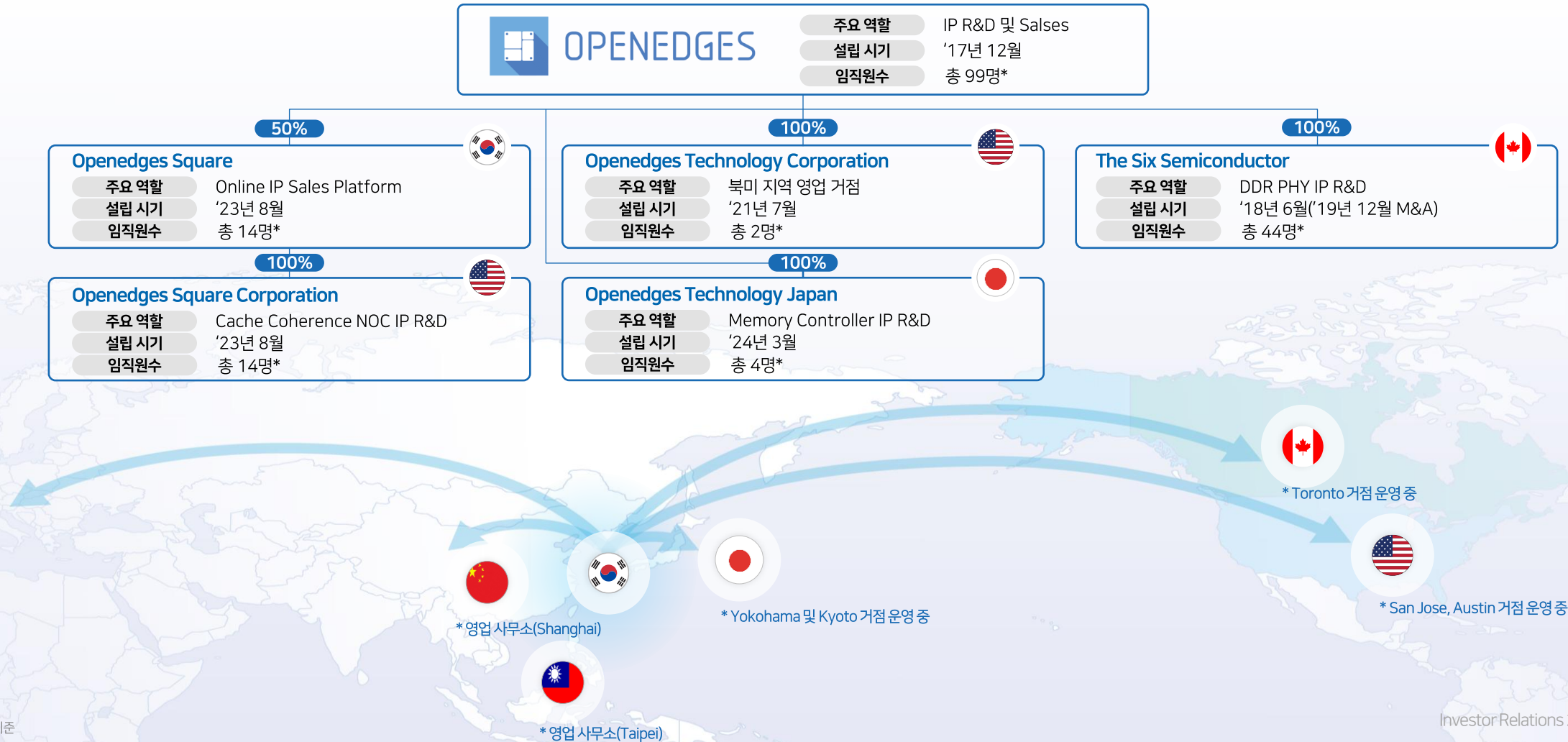
01 | 오픈엣지테크놀로지 핵심경쟁력 Summary

오픈엣지는 AI 반도체 IP 시장의 글로벌 리더가 되기 위한
핵심 성공요인을 확보



02 | 글로벌 최고 수준의 Manpower - Global Presence

미국, 캐나다, 일본 해외 법인 외 글로벌 거점 확대



02 | 글로벌 최고 수준의 Manpower

국내 최대 규모 및 Global 경쟁력을 갖춘 R&D Engineer들이 확보된 반도체 IP 설계기업



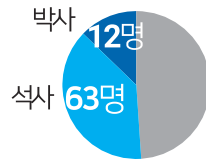
전사 R&D 인력현황

총인원(177명)의

86%

 **153명**
R&D 인력
R&D 인력중
석박사(75명)비중

49%



지역별 현황



한국 113명



캐나다 44명



미국 16명



일본 4명

※ '24년 9월말 기준



이성현
대표이사/CEO

SAMSUNG | SAMSUNG ADVANCED INSTITUTE OF TECHNOLOGY

서울대학교 전기·컴퓨터공학 박사 수료
'17~ 現 오픈엠티테크놀로지(주) 대표이사
'08~'15 삼성전자 수석연구원 (Exynos 개발)
'07~'08 삼성종합기술원



최정환
NPU 팀장

SK hynix | SAMSUNG

Purdue대학교 전기 및 컴퓨터공학 박사
'18~ 現 오픈엠티테크놀로지(주) NPU팀장
'15~'18 SK 하이닉스 수석연구원
'09~'14 삼성전자 Architecture Lab 파트장



Richard Fung
TSS/CEO

AMD | PERASO

Univ. of Toronto 전기전자공학 석사
'18~ 現 The Six Semiconductor CEO
'12~'18 Peraso Technologies Silicon Director 등
'00~'11 AMD PHY Analog Design Manager



Roger Jennings
OSC / VP
of Engineering

ARTERIS | AMD | intel

Univ. of Memphis 전자전기공학 석사
'22~ 現 오픈엠티스퀘어 미국법인 VP of Engineering
'20~'22 Arteris IP Senior Director of Engineering
'02~'20 Intel, Juniper Networks, AMD 등



황인조
CTO/Co-founder

Codeholics/ codeholics | 대우전자 | Chips&Media

서울대학교 전기공학 석사
'17~ 現 오픈엠티테크놀로지(주) CTO
'10~'15 코드홀릭스 CTO
'00~'10 대우전자, 칩스앤미디어



Takashi Yamada
OTJ/Regional VP

socionext | Panasonic

University of Tokyo Denki, 전기공학 학사
'24~ 現 오픈엠티테크놀로지 일본법인 Regional VP
'15~'24 SOCIONEXT Inc., Principal Engineer
'88~'15 PANASONIC Corporation



Ricky Lau
TSS/CTO

AMD | synopsys

Univ. of Toronto 전기전자공학 석사
'18~ 現 The Six Semiconductor CTO
'14~'18 Synopsys PHY Digital Design Engineer
'03~'14 AMD PHY Analog Design Engineer 등



Niranjan Cooray
OSC/Chief Architect

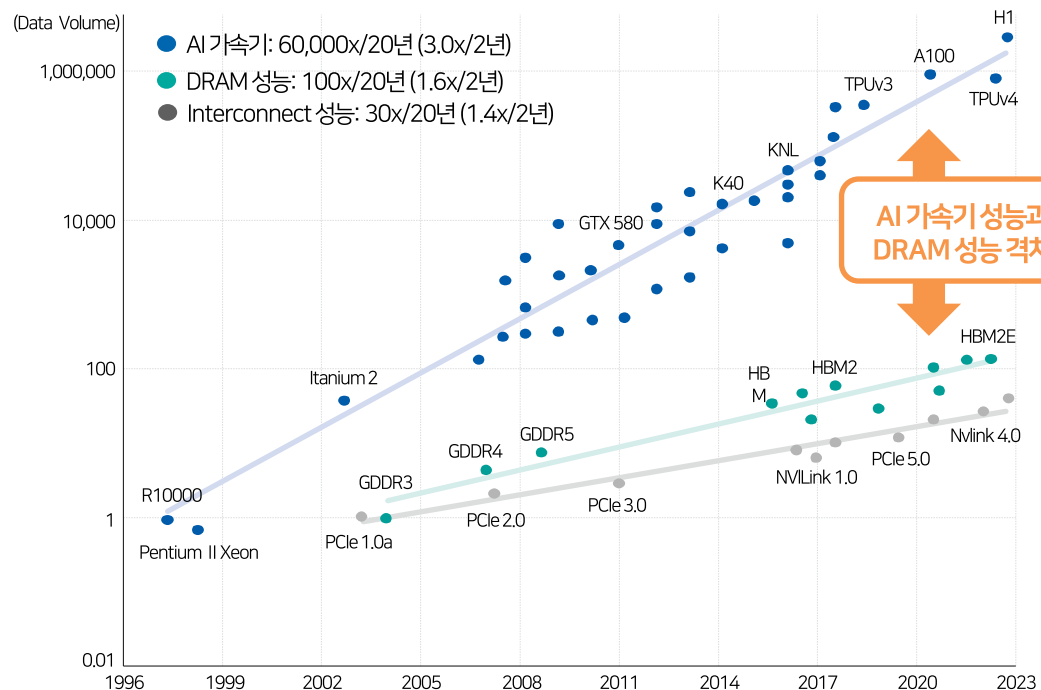
intel

Northeastern University, 전기 및 컴퓨터공학 석사
'24~ 現 오픈엠티스퀘어 미국법인, Chief Architect
'95~'24 Intel, Principal Engineer

03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ①

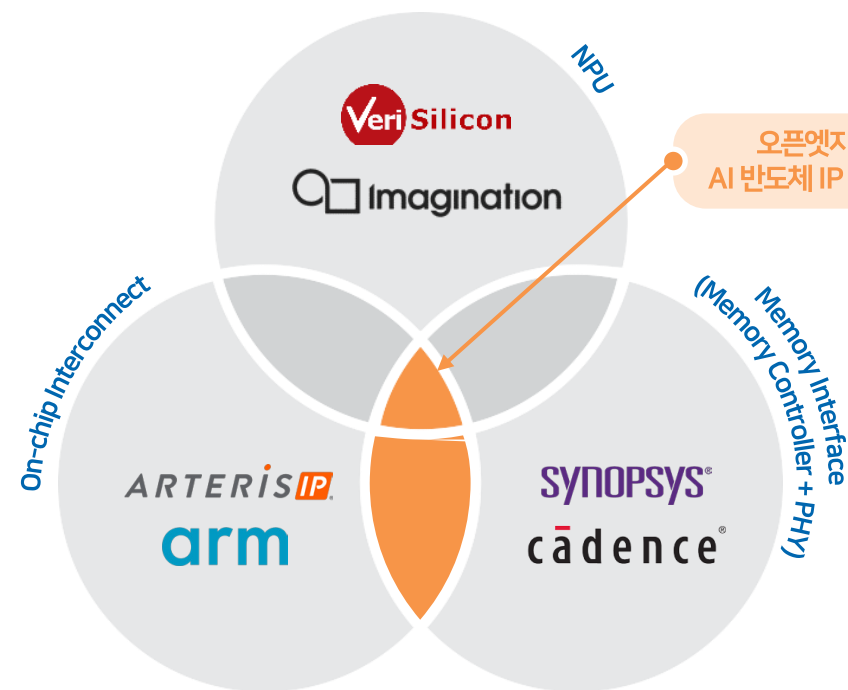
AI 반도체는 'Data Intensive Computing' → 자원이 제약된 엣지 환경 아래 NPU와 메모리 시스템 최적화가 필수
오픈엣지는 글로벌 유일 AI 반도체 통합 IP 솔루션 공급 가능 업체

AI 가속기 기술 발전에 따라 Data 처리 요구량과
DRAM에서 제공하는 성능 간 격차 확대



AI Platform IP for Edge Computing

오픈엣지는 AI 반도체의 핵심인 NPU IP와 모든 반도체의 'Back Bone' 역할을 하는 메모리 시스템 IP 동시 공급이 가능한 글로벌 유일한 회사



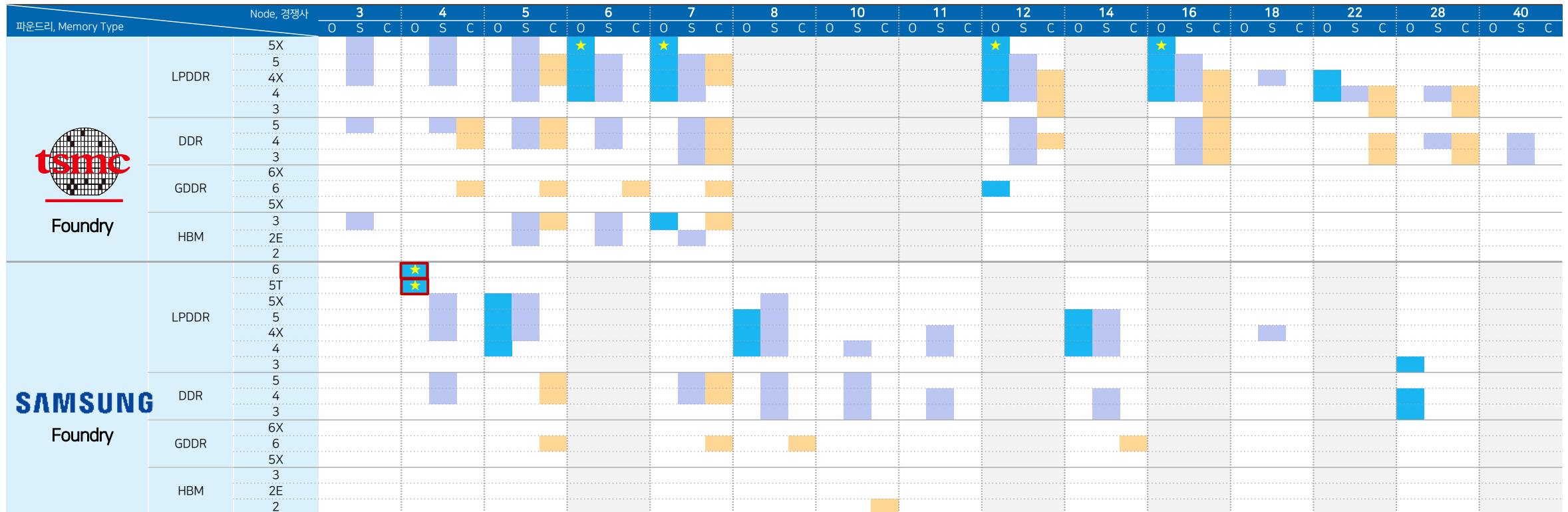
03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ②

최선단 공정 중심 기술개발을 통한 시장선도 및 경쟁력 강화

구분	IP	Description	개발현황	Remark
AI Platform IP Solution for Edge Computing	ENLIGHT™ (Neural Processing Unit)	ENLIGHT™-Light (0.25 ~ 2 TOPS)	Now	경량 IoT 응용제품(키워드 인식, 보안카메라 급 응용)
		ENLIGHT™-Classic (2 ~ 16 TOPS)	Now	중급 이상 IoT 응용제품(자율주행 보조 급 응용)
		ENLIGHT™-Pro (16 ~ 250 TOPS)	Now	차량용 고성능 응용제품(레벨3급 이상 자율주행 차량 응용)
		ENLIGHT™-Hyper (250 ~ 1000 TOPS)	개발 예정	차량용 고성능 응용제품(레벨4급 이상 자율주행 차량 응용, multi-die 버전)
Total Memory System Solution IP (ORBIT™)	OMC™ (DDR Memory Controller)	DDR4/3, LPDDR4X/4/3	Now	
		LPDDR5X/5/4X/4	Now	현재 Mainstream 기술
		HBM3	Now	서버 및 초고성능 제품 향
		DDR5	Now	현재 Mainstream 기술
		GDDR6	Now	고성능 AI 제품 향
		GDDR7	개발예정	차세대 고성능 AI 제품 향
		LPDDR6	개발 중 (~'25년)	차세대 Mainstream 기술
	OPHY™ (DDR PHY)	LPDDR4X/4	Now	TSMC 22nm 공정용
		LPDDR5X/5/4X/4	Now	TSMC 16nm 공정용
		LPDDR5X/5/4X/4	Now	TSMC 12nm 공정용
		GDDR6	Now	TSMC 12nm 공정용
		LPDDR5X/5/4X/4	Now	TSMC 6/7nm 공정용
		HBM3	Now	TSMC 6/7nm 공정용
		LPDDR6	개발 예정	TSMC 4nm 이하 공정용
		LPDDR3, DDR4/3	Now	Samsung 28nm 공정용
		LPDDR4X/4, LPDDR5/4X/4	Now	Samsung 14nm 공정용
		LPDDR5/4X/4	Now	Samsung 8nm 공정용
		LPDDR5X/5/4X/4	Now	Samsung 5nm 공정용
		LPDDR5T	개발 중 (~'25년)	Samsung 4nm 공정용
		LPDDR6	개발 중 (~'25년)	Samsung 4nm 공정용
		GDDR7	개발 예정	-
	OIC™ (On-Chip-Interconnect)	OIC™	Now	Non-Cache-Coherent NoC
		OIC™-AI	개발 중	Cache-Coherent NoC

글로벌 주요 경쟁사가 cover하지 못하는 영역에서 역량을 집중, 시장 점유율 확대

Openedges Synopsys Cadence



- Synopsys와 Cadence는 TSMC 5나노 이하 선단 공정에 집중
- 특히 다수의 공정에서 LPDDR5X/5 용 PHY IP는 주요 IP Vendor들 중 유일하게 개발하여 고객에게 제공 중
- '25년까지 SF 4nm PHY IP 개발을 통해 선단 공정 관련된 IP강화 및 고객사 POOL 확대 기대 중
- 경쟁사 대비 50% 이하의 면적으로 구현한 test chip에서의 성능 확보를 통한 제품 경쟁력 제고

03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ④

최선단 공정의 지속 개발을 통해, AI 반도체 통합 IP 솔루션의 선점 효과를 극대화할 예정

예상 출시 일정		2021		2022		2023		2024		2025	
		1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H
ENLIGHT™ Neural Processing Unit		NPU v1.0		NPU v2.0				NPU v3.0 Autonomous Driving		NPU4.0 Autonomous Driving	
		[성능] 0.25~2 TOPS	[타겟제품] 경량 IoT 응용제품 (카워드 인식, 보안카메라 응용)	[성능] 2~16 TOPS	[타겟제품] 중급 이상 IoT 응용제품 (자율주행 보조급 응용)	[성능] 16~250 TOPS	[타겟제품] 차량용 고성능 응용제품 (Level 3급 이상 자율주행 차량 응용)	[성능] 250~1,000 TOPS	[타겟제품] 차량용 고성능 응용제품 (Level 4급 이상 자율주행 차량 응용 Multi-Die 버전)		
		보안 카메라		E-Mirror 등 운전자 지원 시스템		완전 자율주행					
OIC™ On-Chip Interconnect	Non-Cache Coherent NOC	OIC v. 1.X						OIC v. 2.0			
	Cache Coherent NOC									OIC-AI	
OMC™ Memory Controller		GDDR6	LP5X/5 /4X/4		HBM3	DDR5				LP6	
OPHY™ DDR PHY	SAMSUNG		LP4/4X/5 (14nm)				LP5X/5/4X (5nm)			LP6 (4nm)	
	tsmc			LP4/4X/5 GDDR6 (12nm)	LP4/4X/5 (22nm)	HBM3 LP4X/5/5X (6/7nm)		LP5X/5/4X (12/16nm)		DDR5 (5nm)	
OUC Controller Die to Die (Chiplet Controller)									UCIe v1.1 Controller (AXI streaming)		UCIe v1.1 Controller (Full spec.)
OPHY™ PHY Die to Die (Chiplet)	SAMSUNG										OPHY-D2D (5/8nm)
	tsmc										OPHY-D2D (6nm)

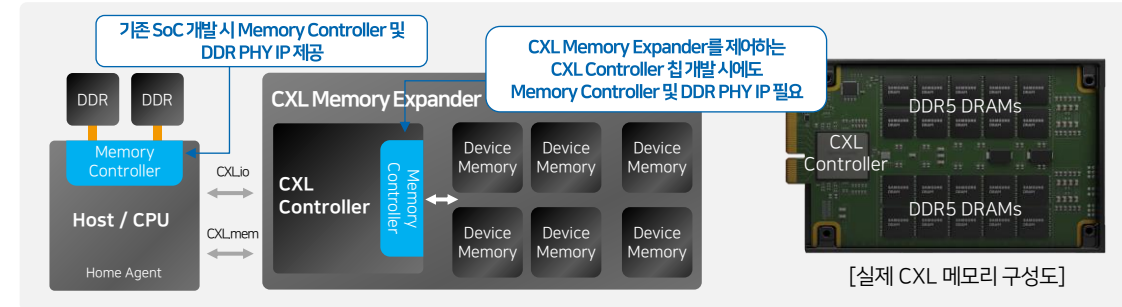
● 2023년 R&D 착수 ● 2024년, 25년 R&D 착수

03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ⑤

고부가가치 차세대 반도체 기술 분야에서 메모리사와 협력 확대

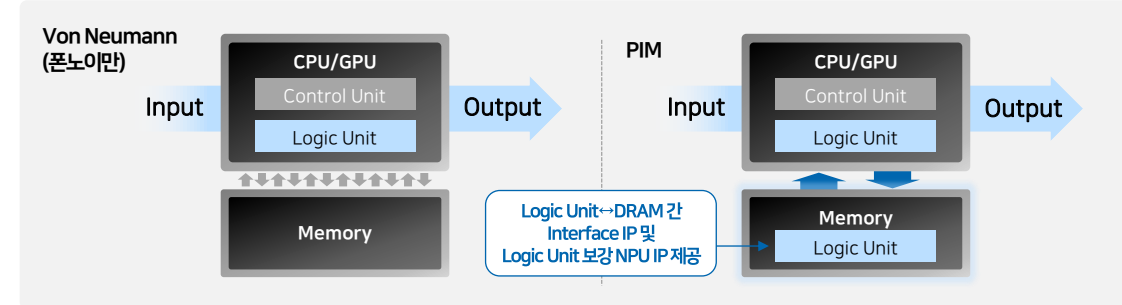
CXL (Compute Express Link)

- CXL interface는 기존의 Host/CPU에 종속적인 메모리 표준 용량 및 성능에 대한 제한 없이, 유연하게 메모리를 확장 가능 → AI 반도체와 같은 **Data Intensive 고성능 연산 효과적 지원**
- 오픈엣지는 CXL Memory Expander의 핵심인 **CXL Controller 칩 설계용 IP를 공급**



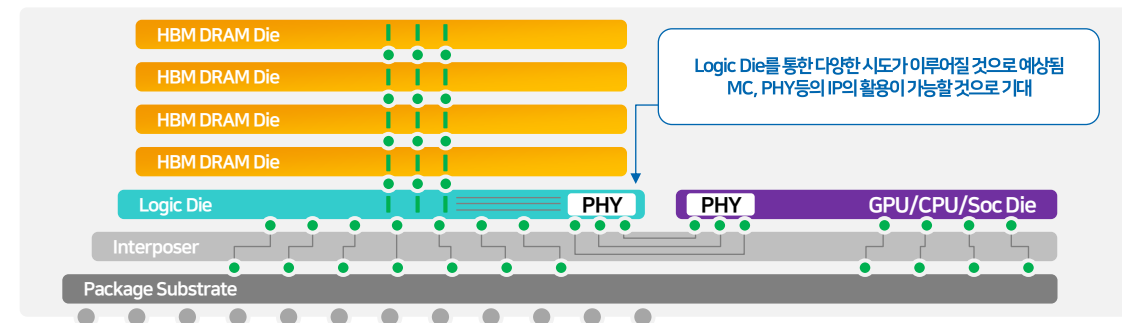
PIM (Process-in-Memory)

- PIM은 Host/CPU에서 담당(폰노이만 구조)하는 연산기능의 일부를 off-loading하여 PIM에서 처리 → **연산/저장기능 동시 수행으로 속도 ↑ + 전력소모 ↓**
- 오픈엣지는 PIM 반도체 내 Logic Unit과 DRAM 간 **Data Interface를 담당할 Memory System IP와, Logic Unit의 성능 향상에 필요한 NPU IP를 공급 가능**



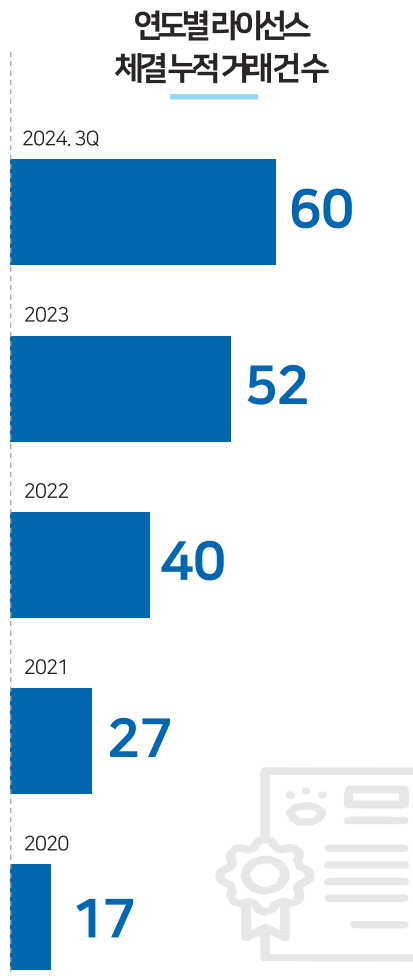
HBM4

- HBM4 부터는 **Base Die가 Logic Die로 장착**되며 다양한 기능들을 활용하게 될 것으로 예상됨 → HBM3E부터 시도 중이지만, 본격적인 적용은 HBM4부터 될 것으로 예상
- **Logic Die 내 Memory Controller, PHY 등 당사의 주력 IP가 탑재**될 가능성이 높은 상황 → 오픈엣지는 이미 HBM Memory Controller 및 PHY를 보유하고 있으며, 고객사 요청이 발생할 경우 이에 대해 Customization을 진행할 수 있음



04 | 검증된 글로벌 Track Record

다양한 산업의 필수 솔루션으로 가치를 인정받아 글로벌 Track Record 확대 중



05 | 글로벌 기업과의 전략적 Partnership

안정적 IP 수요 확보 + 최신 기술 및 시장 트렌드에 대한 선도적 대응

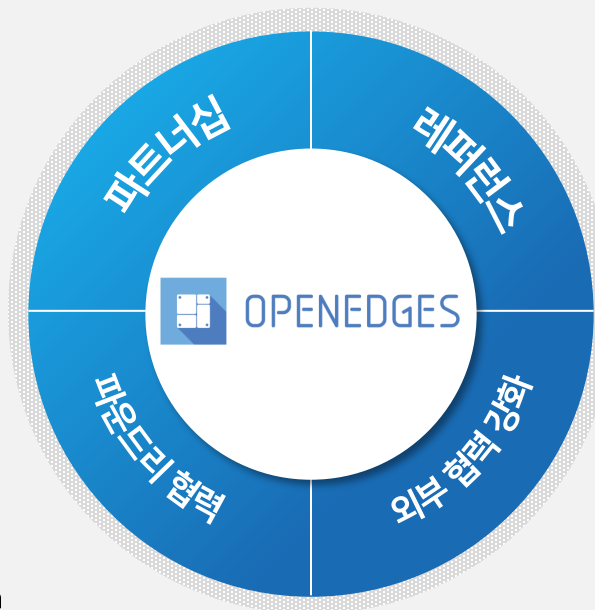
타 IP 기업과의 Partnership 강화



파운드리 협력관계 강화



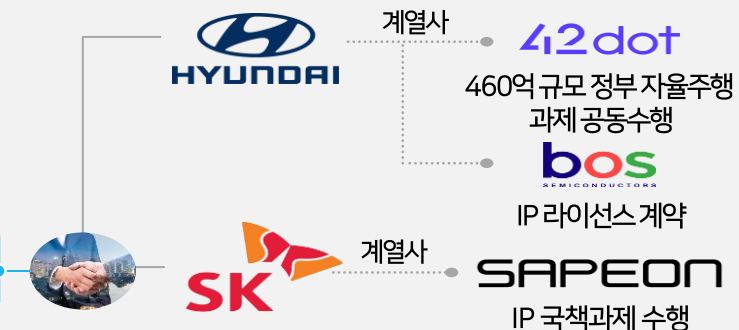
- 당사PHY IP 라이선스 2개사가 설계 완료 후 TSMC에서 양산 진행 및 준비 중
- 양산 실적 확보 시 TSMC IP Alliance Program 정식 파트너로 편입될 예정(OIP*)
- 2018년 SAFE** IP 파트너 선정
- 메모리 인터페이스 분야 IP 협력 확대 중



Top tier 고객 확보를 통한 Reference 확보



외부 기업들과의 협력방안 모색



* 주1) OIP (Open Innovation Platform)

** 주2) SAFE (Samsung Advanced Foundry Ecosystem)

03

2024년 3Q 경영실적

- 01. 매출
- 02. 영업이익
- 03. 수주현황

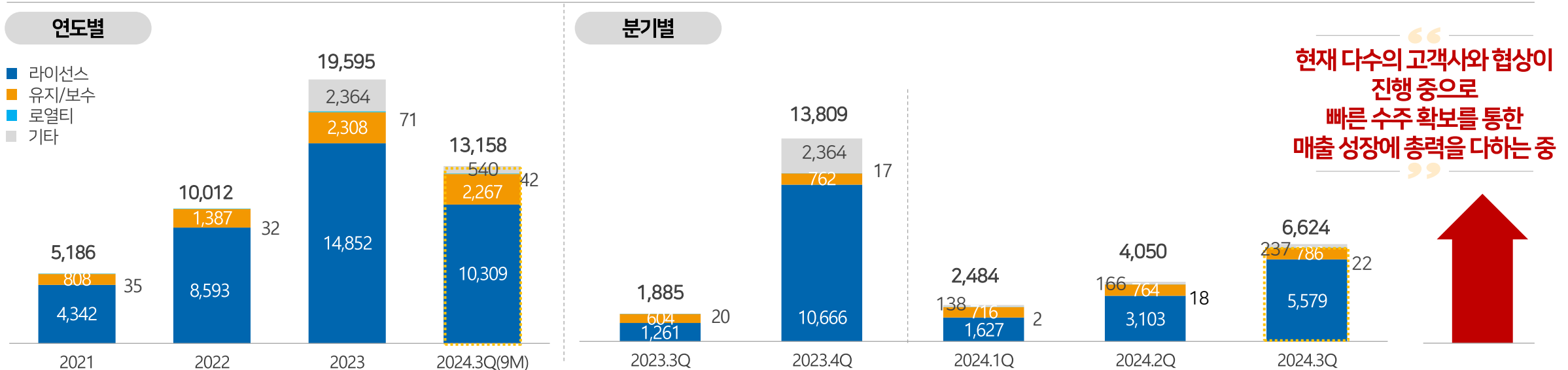


01 | 매출

'24년 3Q 매출은 신규 수주 등의 영향으로 66.2억원을 기록
전분기 대비 63.1% (QoQ), 전년 동기 42.5%(YoY) 상승

● 매출 현황

(단위: 백만원)

매출
변동요인

라이선스

분기 라이선스 매출이 지속적으로 성장하고 있어 수익성의 개선이 이루어지고 있음

유지보수

기 체결 IP 라이선스 계약 중 총 31개 Project에서 지속적인 기술지원을 통한 유지보수 매출 발생

로열티

고객사 양산에 따라 매출 발생 중이며, 분기별로 지속적인 우상향을 보이고 있음

기타

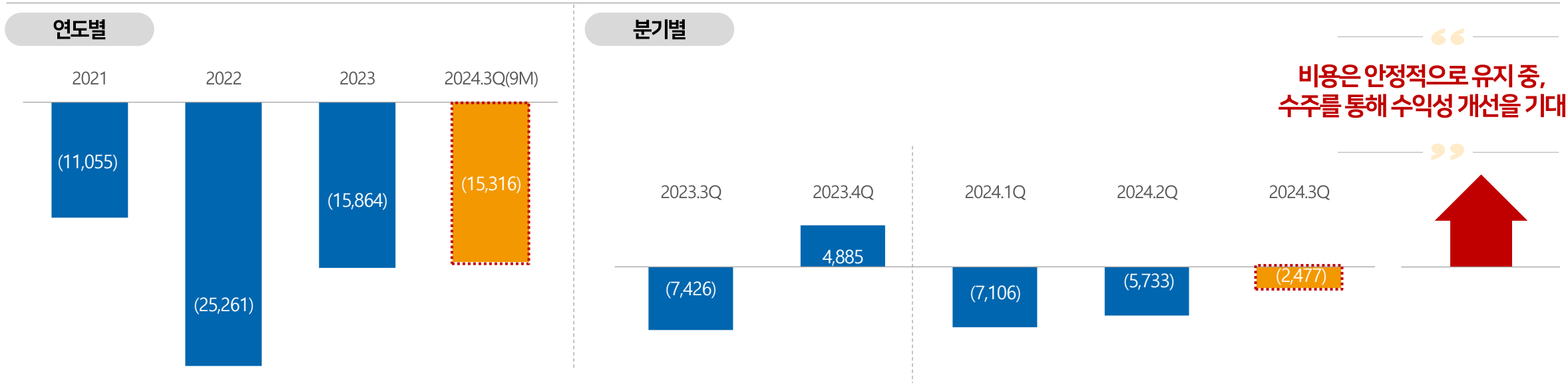
오픈엣지스퀘어향 운영 및 기술 지원 서비스에 대한 매출로 분기당 1~2억 내외로 발생 중임

02 | 영업이익

'24년 3Q는 영업손실 25억원을 기록, 전분기 대비 적자폭 개선
비용은 91억을 기록했으며, 연구개발비가 80%를 차지함

● 영업이익 현황

(단위: 백만원)

영업이익
변동요인

- ✓ 라이선스 매출 상승으로 전 분기 대비 적자폭 감소, 비용은 큰 변동없이 안정적으로 운영 중
- ✓ R&D 비용은 신규 IP 개발 관련 비용이며, 전체 비용 중 80%를 차지
- ✓ 라이선스 수주 논의가 완료될 경우 수주잔고 확대 및 매출 증대로 수익성 개선 기대

03 | 수주현황

'24.3분기는 당초 기대했던 Tier-1 고객사 Project 다수가 연기되어 수주 확대가 부진했으나, 역대 최대 규모 수준인 수주 후보와의 신속한 라이선스 계약 체결을 통해 안정적인 매출 성장 추진 중

● 수주 현황

(단위: USD 1million)

□ '24년 3분기 : 신규 라이선스 계약 1건, 총 \$1.2M 수주

- 당초 기대했던 Tier-1 고객사 Project 착수 일정이 다수 연기되며 1건 수주 확보
- 논의 중인 수주후보 중 연내 확보 가능한 계약을 마무리하기 위해 회사 역량을 집중 중

□ '24년 누적(~3Q) : 라이선스 계약 8건, 총 \$8.3M 수주

- '23년 누적(~3Q) 수주금액(\$8.0M)과 동등 수준
- 계약 건당 평균금액(ASP)은 \$1.0M으로 전년 동기 \$0.8M 대비 \$0.2M 증가

'24.3Q 수주 실적

(단위:수/\$M)	'24. 3Q (3개월)	'24.3Q (9개월)	'23.3Q (9개월)	'23년 연간	'22년 연간
건수	1	8	10	12	13
금액	\$1.2M	\$8.3M	\$8.0M	\$15.5M	\$7.5M
(금액/건)	\$1.2M	\$1.0M	\$0.8M	\$1.3M	\$0.6M

● 주요 실적 요인 및 향후 전망

'24년 3분기 실적 요인

□ 당초 기대했던 글로벌 Tier-1 고객사 다수 PJT 착수일정이 연기

- 단, 일부는 당사로의 IP 선정까지는 완료된 상황으로, PJT 재개 즉시 수주규모 확대 가능

□ 수주 후보 규모는 역대 최대 수준이나, 고객사의 의사결정 지연으로 계약 실적 미흡

- Edge AI Chip, Hyperscaler 등 다양한 분야의 고객사들과 수주 협의 중
- 고객사 의사결정 지연 등 영향으로 수주 후보군은 상반기 30개+ 에서 현 50개+ 규모로 확대

'24년 4분기 및 '25년 상반기 예상

□ 연간 수주규모 순성장 달성을 위해 잔여 기간 Deal Closing 총력

- 3Q까지는 당초 계획 대비 수주 확보가 지연되었으나, '23년(\$15.5M) 수주 실적 대비 연간 순성장을 달성토록 잔여 기간 협의 중인 PJT 라이선스 계약을 최대한 마무리할 계획

□ 국내 뿐만 아니라 해외 고객사 Pool 지속 확대로 안정적 매출성장 Potential 증가

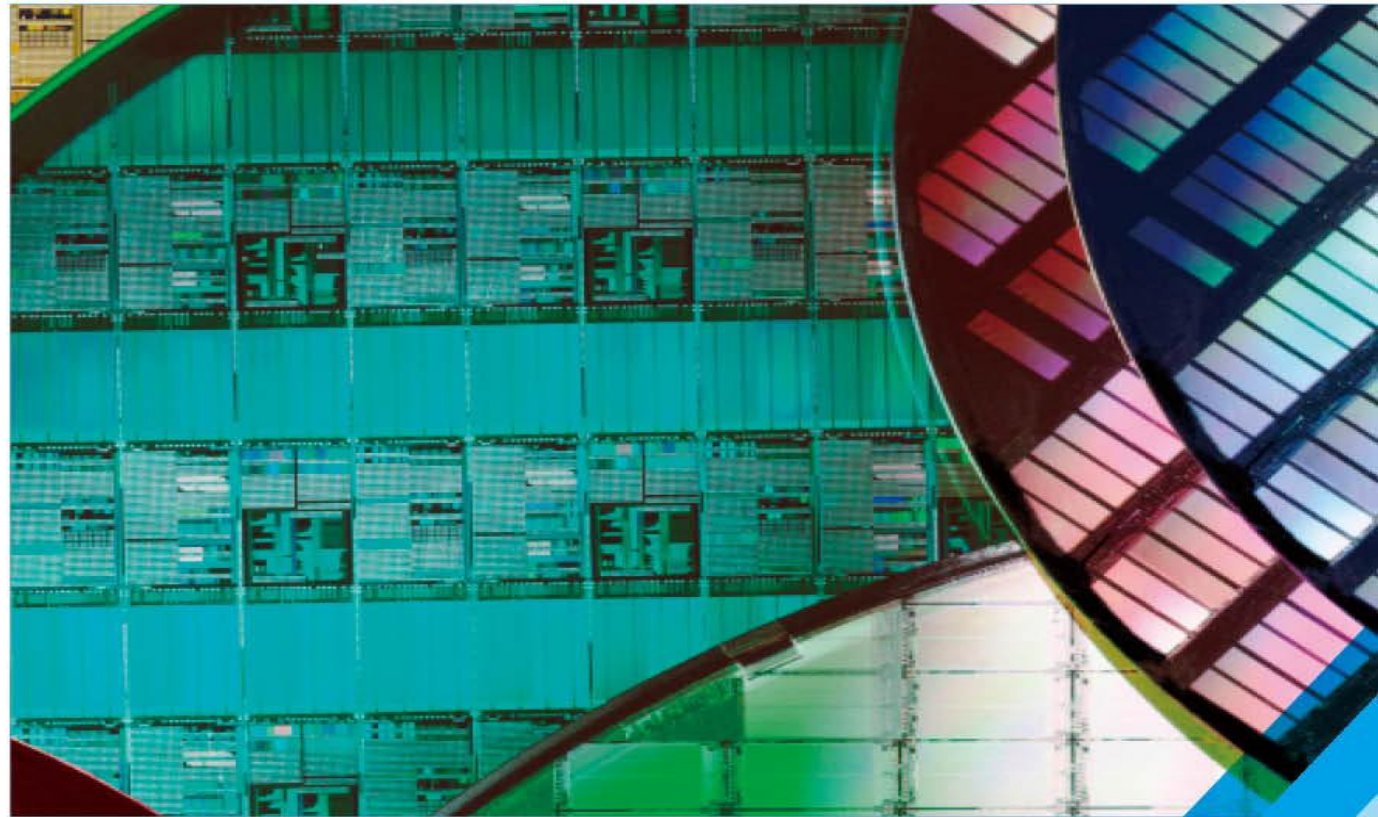
- 현 논의 중인 수주의 70%는 글로벌(중국, 대만, 일본, 미국 등) 고객사가 차지
- 특히, Edge AI용 칩을 설계하는 다수 Fabless와 협의 진행 중으로, 당사가 보유한 고성능 Mem. Controller 및 PHY IP 수요 지속 증가 중 (TSMC 6/7/12/16nm, SF 5/8/14nm 등)



04

중장기 성장전략

- 01. 중장기 성장 방향
- 02. 기존 IP 경쟁력 강화 방안
- 03. 상세 Portfolio 확대
- 04. 경쟁사 IP제품 Portfolio 현황

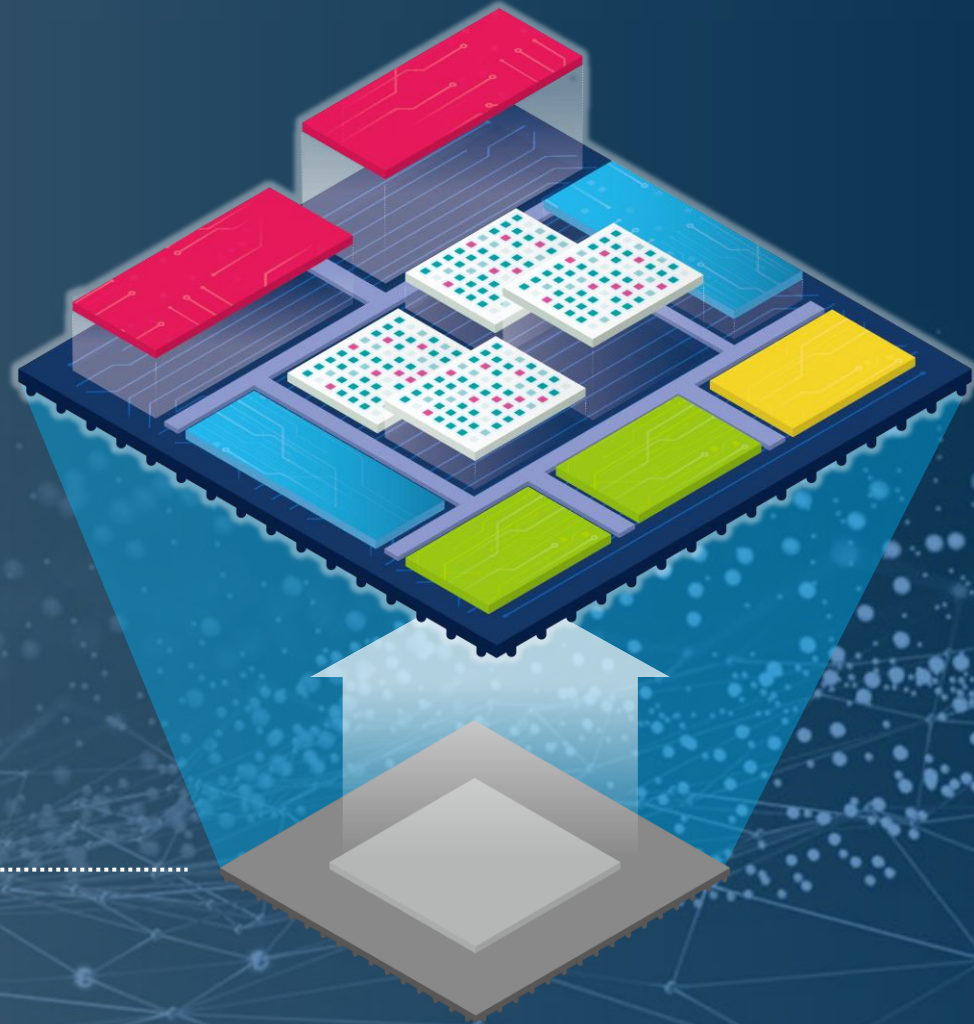


01 | 중장기 성장 방향

AI 반도체 Total IP Solution 으로
Portfolio 확장

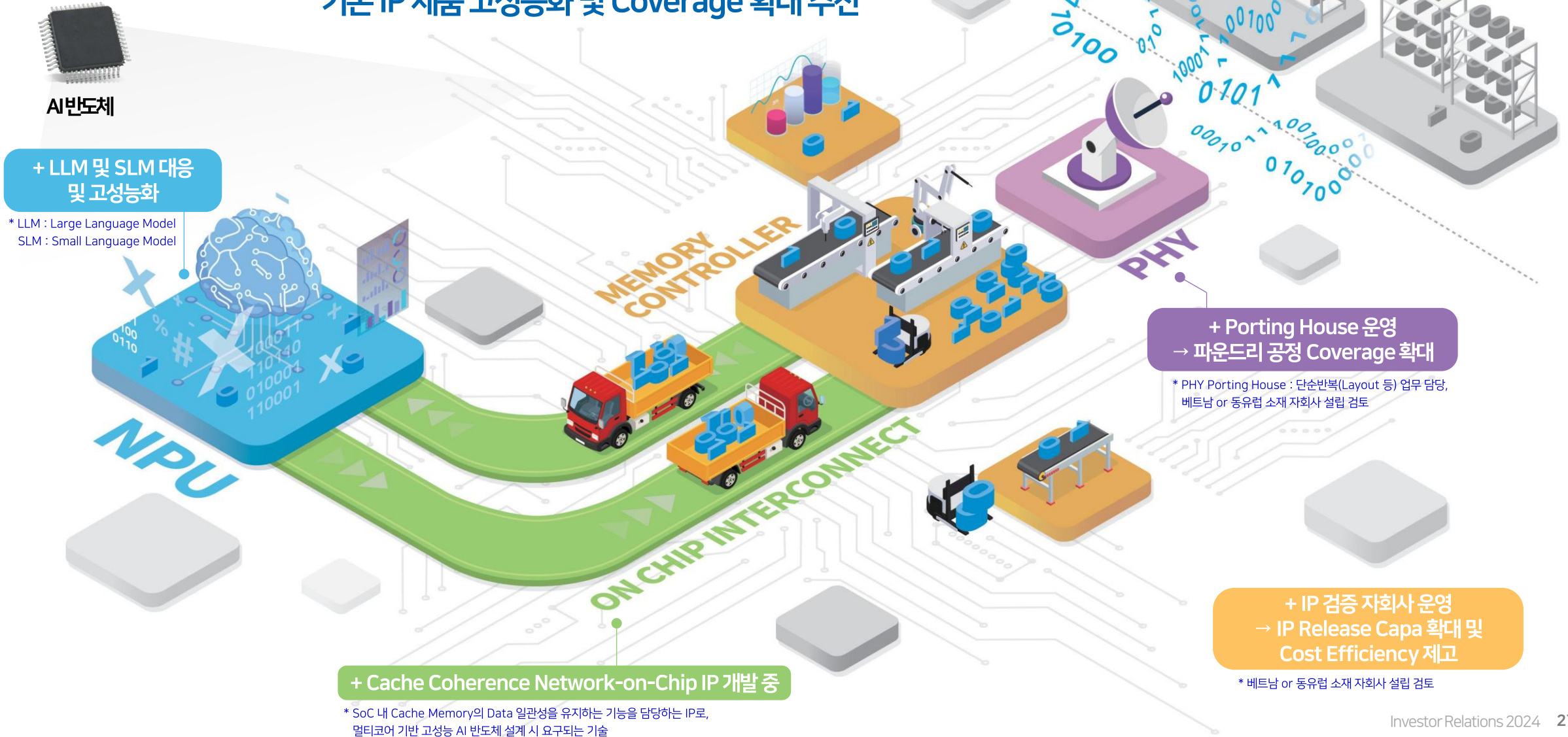
Multi Die/Chip

On-die



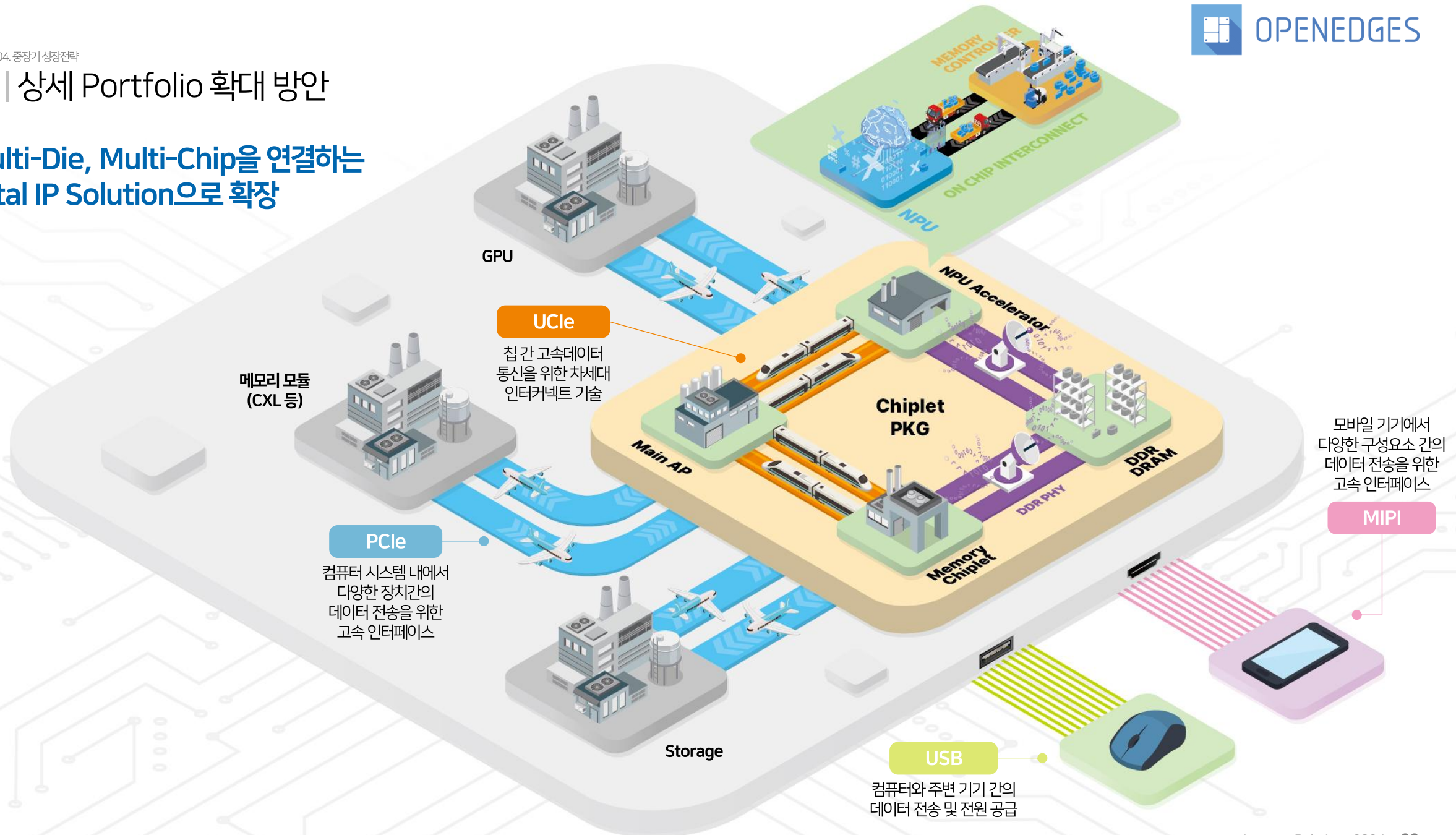
02 | 기존 IP 경쟁력 강화 방안

기존 IP 제품 고성능화 및 Coverage 확대 추진



03 | 상세 Portfolio 확대 방안

Multi-Die, Multi-Chip을 연결하는 Total IP Solution으로 확장



04 | 경쟁사 IP제품 Portfolio 현황

2030년까지 Wired Interface IP 분야 핵심 IP별 개발 착수 후 2년내 상업화를 통해 제품 포트폴리오 완성도 제고

글로벌 Top 5 IP 기업 vs. 오픈엣지 제품 Portfolio 비교

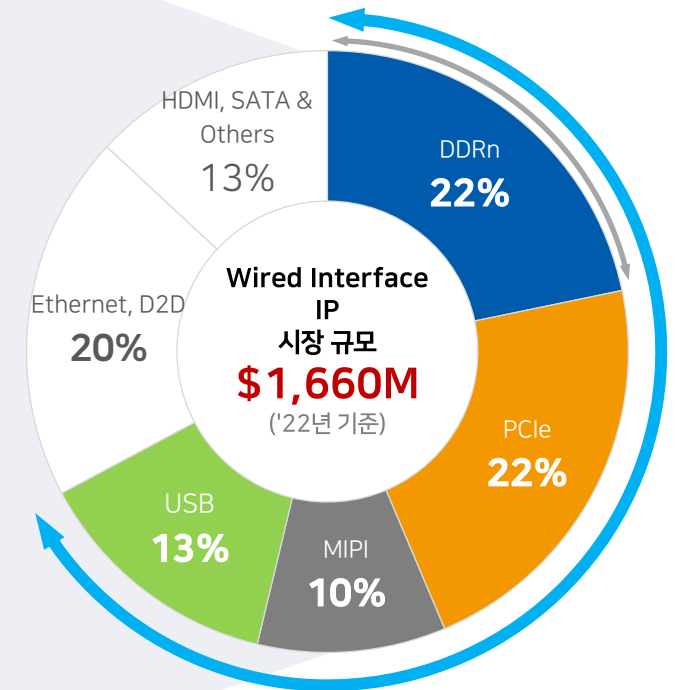
구 분		오픈엣지	arm	Synopsys	Cadence	Alphawave Semi	Imagination Technologies
Processor IP	CPU (Central Processing Unit)	-	●	●	-	-	●
	GPU, ISP (Image Signal Processor)	-	●	- * RISC-V 기반	-	-	●
	DSP (Digital Signal Processor)	-	-	●	●	-	-
	NPU (Neural Processing Unit)	●	○	○	○	-	●
Physical IP	Wired Interface IP	DDR Cont'r/PHY	●	-	●	●	-
		HBM Cont'r/PHY	●	-	●	●	-
		UCle Cont'r/PHY	★	-	●	●	-
		PCIe Cont'r/PHY	★	-	●	●	-
		CXL Cont'r/PHY	★	-	●	●	-
		Ethernet	-	-	●	●	-
		USB	★	-	●	-	-
		SATA(Serial ATA)	-	-	●	-	-
		HDMI	-	-	●	-	-
		Display Port	-	-	●	-	-
		MIPI	★	-	●	-	-
	Memory Compilers (Others)		-	-	●	-	-
	Standard Cell & I/O		-	●	●	-	-
	Memory Compilers (SRAM)		-	●	●	-	-
	Analog & Mixed Signal		-	-	●	●	-
	Wireless Interface IP		-	-	●	-	-
Other Digital IP	Miscellaneous IP		-	-	●	-	-
	System IP (CC NoC, NCC NoC 등)		●	●	○	○	-
	Security IP		-	●	-	-	-

* ○: 당사가 시장에서 경쟁한 이력이 부족한 Non-Major 경쟁상대로 판단 (Low-end 중심)

★: 오픈엣지 추가 진출 후보군 ★: 2025년 / ★: 2026년 / ★: 2027년~

당사 참여 시장 Coverage 확대

22% ➔ 67%



※ D2D(UCle) 시장은 '22년 시장규모가 미미하여 Ethernet과 합쳐져 구분이 어려우나, 향후 칩셋 개발수요 증가로 고성장 예상

[Appendix] | 요약연결재무제표

● 요약 연결재무상태표

(단위: 백만원)

	3Q24	2023	2021	2020
유동자산	79,951	29,843	44,304	29,020
비유동자산	10,441	14,849	9,552	7,077
자산총계	90,392	44,692	53,855	36,097
유동부채	18,301	19,750	18,318	9,171
비유동부채	4,777	4,371	3,288	6,374
부채총계	23,078	24,121	21,606	15,545
자본금	2,480	2,146	2,116	1,653
자본잉여금	160,370	98,259	96,376	58,927
기타자본항목	3,483	3,577	2,026	3,007
이익잉여금	△99,019	△83,412	△68,269	△43,035
자본총계	67,314	20,571	32,249	20,553

※ 연결재무제표 기준

● 요약 연결손익계산서

(단위: 백만원)

	3Q24	2Q24	증감	증감(%)
영업수익	6,624	4,050	2,574	64%
영업비용	9,101	9,784	△683	△7%
R&D 비용	7,095	7,816	△721	△9%
기타영업비용	2,006	1,968	38	2%
영업이익	△2,477	△5,733	3,256	적자지속
기타수익	14	28	△14	△50%
기타비용	492	4	488	12,200%
금융수익	608	292	316	108%
금융비용	411	345	66	19%
세전이익	△2,757	△5,762	3,005	적자지속
법인세비용	△18	-	△18	N/A
당기순이익	△2,739	△5,762	3,023	적자지속

※ 연결재무제표 기준

[Appendix] | Financial Summary

Financial Summary

(단위: 백만원)

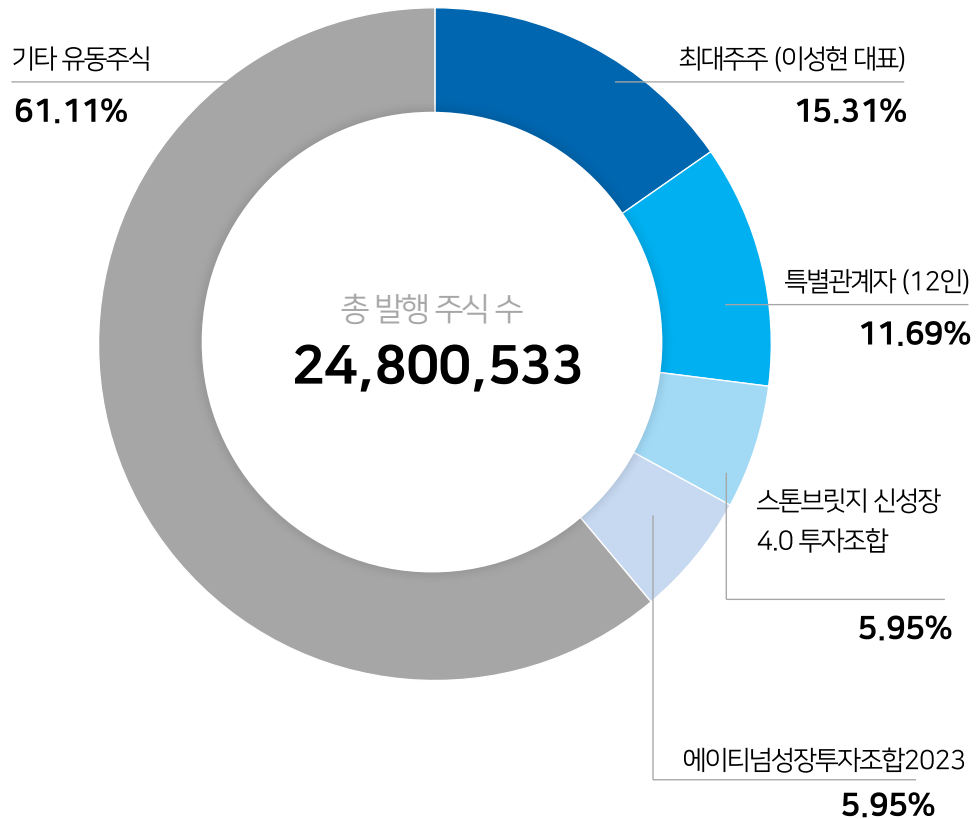
연결재무제표	2019	2020	2021	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	2022	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2023	1Q24	2Q24	3Q24
매출	1,238	1,089	5,186	3,033	3,975	1,577	1,426	10,012	1,059	2,842	1,885	13,809	19,595	2,484	4,050	6,624
라이선스	990	660	4,342	2,798	3,619	1,175	1,001	8,593	555	2,370	1,261	10,666	14,852	1,627	3,103	5,579
유지보수	249	423	808	230	350	392	415	1,387	487	454	604	762	2,308	716	764	786
로열티	-	6	35	5	7	10	10	32	17	18	20	17	71	2	18	22
기타매출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,363	2,363	138	166	237
비용	4,422	8,896	16,241	5,792	7,293	7,844	14,344	35,273	8,801	8,422	9,311	8,924	35,458	9,589	9,784	9,101
R&D 비용	2,347	6,623	10,654	3,937	5,361	6,063	12,349	27,710	7,052	6,546	7,146	6,439	27,184	7,543	7,816	7,095
기타영업비용	2,075	2,273	5,587	1,855	1,932	1,782	1,995	7,563	1,749	1,876	2,165	2,485	8,275	2,046	1,968	2,006
영업이익	△3,183	△7,807	△11,055	△2,759	△3,317	△6,267	△12,918	△25,261	△7,742	△5,581	△7,426	4,885	△15,864	△7,106	△5,733	△2,477
법인세차감전이익	△8,487	△18,729	△14,524	△2,906	△3,398	△6,181	△12,362	△24,846	△7,634	△5,559	△7,317	6,000	△14,510	△7,106	△5,762	△2,757
당기순이익	△8,487	△18,729	△14,608	△2,906	△3,398	△6,178	△12,745	△25,227	△7,631	△5,557	△7,310	5,642	△14,856	△7,106	△5,762	△2,739

※ 연결재무제표 기준

[Appendix] | 주주 현황

최대 주주 (이성현 대표) 지분율 15.31%, 특별 관계자 (12인) 합산 시 27%
유상증자로 스톤브릿지와 에이티넘이 각각 5.95%씩 지분 취득

주주 현황 (기준일: '24.9.30.)



Name	Type	# of shares	%
최대주주 (이성현 대표)	보통주	3,796,314	15.31%
특별관계자 (12인)	보통주	2,899,543	11.69%
스톤브릿지 신성장4.0투자조합	CPS	1,474,853	5.95%
에이티넘성장투자조합2023	CPS	1,474,853	5.95%
기타 유동주식	보통주	15,154,970	61.11%
Total		24,800,533	100.00%

※ 참조: '24.7.22 제3차배정 유상증자를 통해 스톤브릿지와 에이티넘이 각각 전환우선주 1,474,853주씩을 취득함

※ 기준일: '24.9.30.